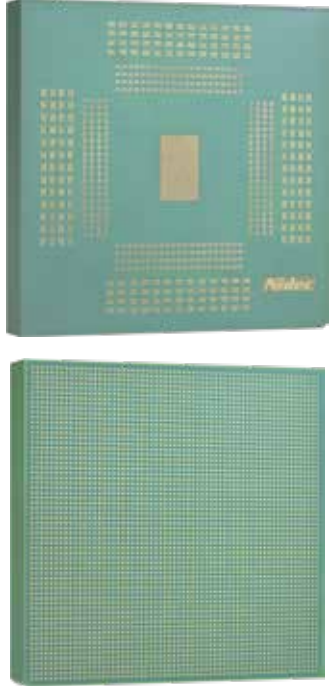
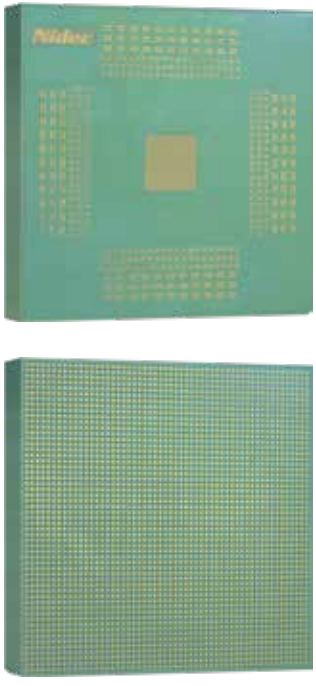
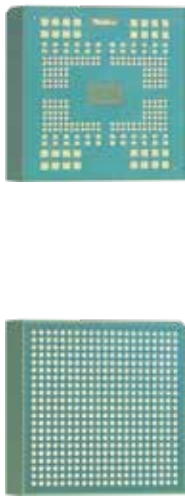
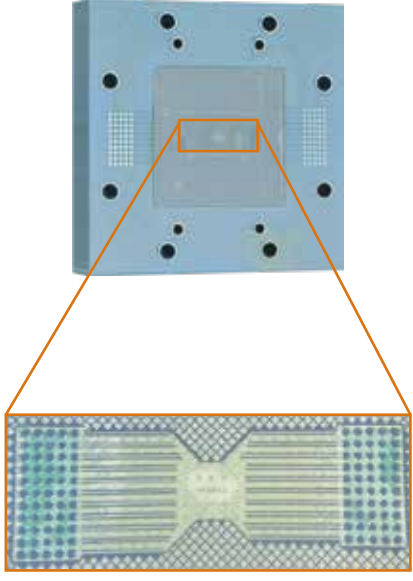


ST MLO Substrate

with Build-up **SAP** technology
SAP = Semi Additive Process

	ST MLO (SAP)			2.5D ST MLO Thin Film + SAP
Sample				
O.D.	65mmSQ	56mmSQ	23.2mmSQ	26mmSQ(RDL) 50mmSQ(MLO)
Layer#	30	←	26	-
Pad Pitch	162um	←	70um	25um
Pad DIA.	120um	←	55um	15um
L/S	20/25um	←	17/25um	3/3um

特徴 | Characteristics

まとまった数量での量産が前提であった微細配線ビルドアップ**SAP ST MLO**基板が少量、試作レベルの数量でカスタム品製作が可能になりました。ぜひ製品開発の一助にお役立てください。

SAP technology only by mega suppliers is now available even for small lot/prototype production as an ideal product development tool.

- カスタム設計歓迎 Custom design welcome
- 30層以上の積層が可能 Capable of more than 30 layers of stacking
- 薄コア基板使用可能 (~40um) Thin core material (~40um)

SAP Design Rule

	~2025	2026 1H~
Via DIA.	25 um	←
Min. Via Land DIA.	50 um	←
Min. L/S	20 / 25 um	15 / 15 um
Min. Probe Pad Pitch	75 um	65 um
Min. Probe Pad DIA.	55 um	50 um

国内拠点

・京都(本社)
617-0007 京都府向日市ニデックパーク33番地C棟
TEL 075-280-8101 / FAX 075-280-8106
・名古屋
503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町1-3
TEL 0584-83-7680 / FAX 0584-83-7685
・東京
141-0032 東京都品川区大崎1丁目20番13号 Nidec東京ビル
TEL 03-3494-7970 / FAX 03-3494-0793

海外拠点

・台湾 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY TAIWAN CORPORATION
・韓国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY KOREA CO., LTD.
・中国 NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY ZHEJIANG CORPORATION
・タイ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY THAILAND CO., LTD.
・マレーシア NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.
・ベトナム NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.
・インド NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
・カナダ NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CANADA CORPORATION